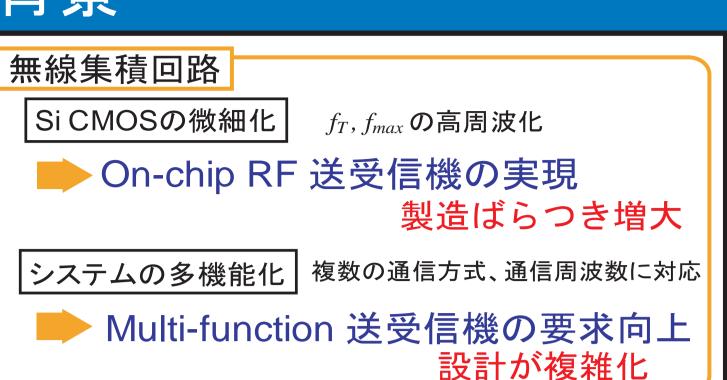
リコンフィギュラブルRF技術によるマルチスタンダード無線通信回路の研究

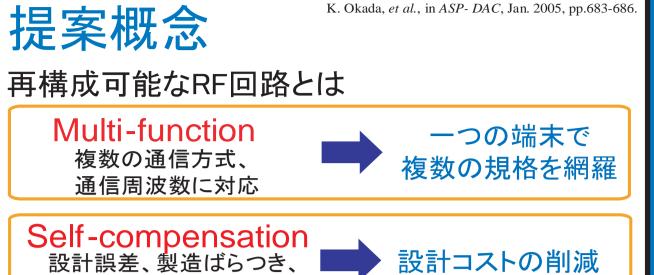
東京工業大学 統合研究院 益研究室

伊藤雄作, 川添太輔, 山内拓弥, 福田聡, 大橋一磨, 岡田健一, 益



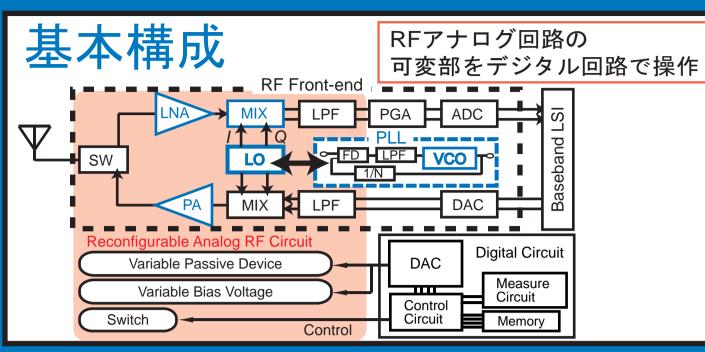


動的再構成可能RF回路



温度の補償

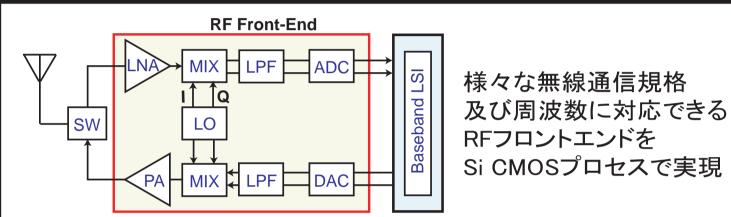
Tunable LNA



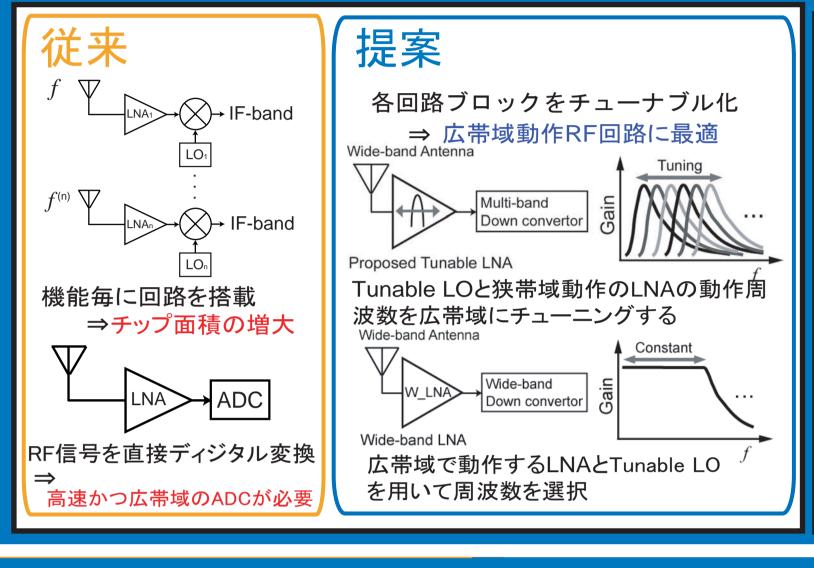
無線通信周波数帯域

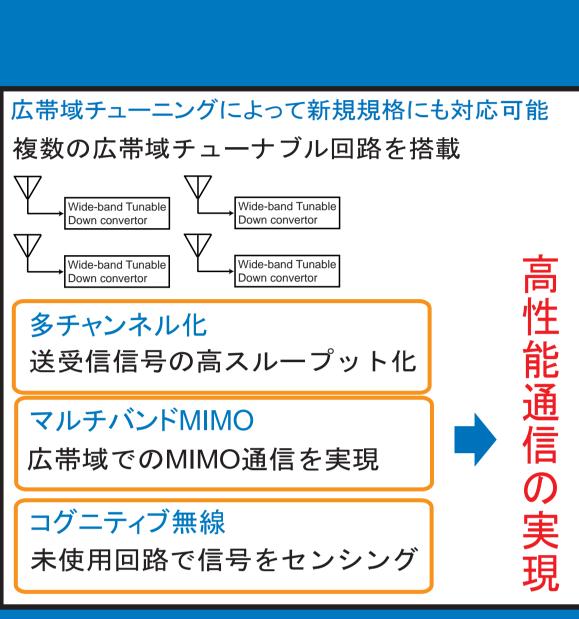
- Mobile phone 800MHz, 1.5GHz, 1.9GHz, 2GHz (+ 700MHz, 900MHz, 1.7GHz for the new system) (+ 800MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz for GSM) 無線回路の WLAN 802.11b/g, Bluetooth 2.4GHz
- GPS 1.2GHz/1.5GHz
- DTV 470 MHz~770 MHz

マルチスタンダード化 ■ WLAN 802.11a/n 4.9GHz~5.875GHz が必須

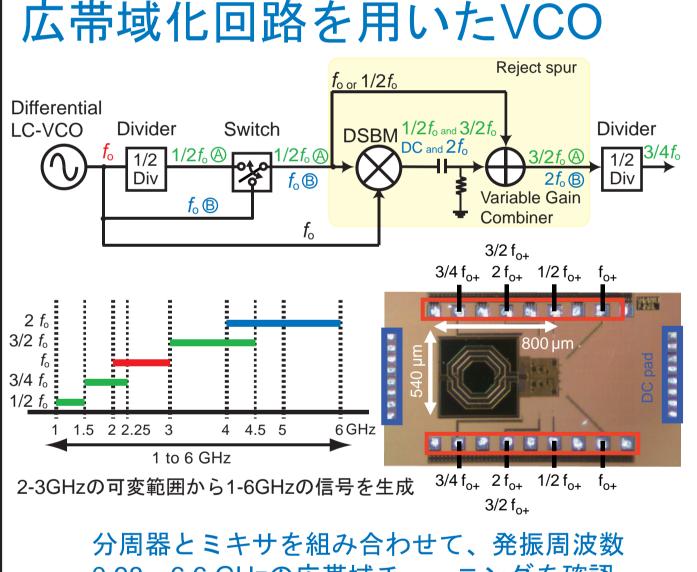


受信部回路アーキテクチャ

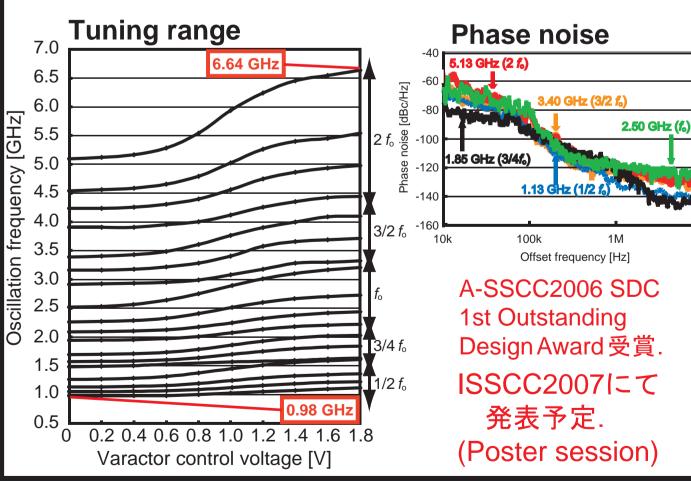




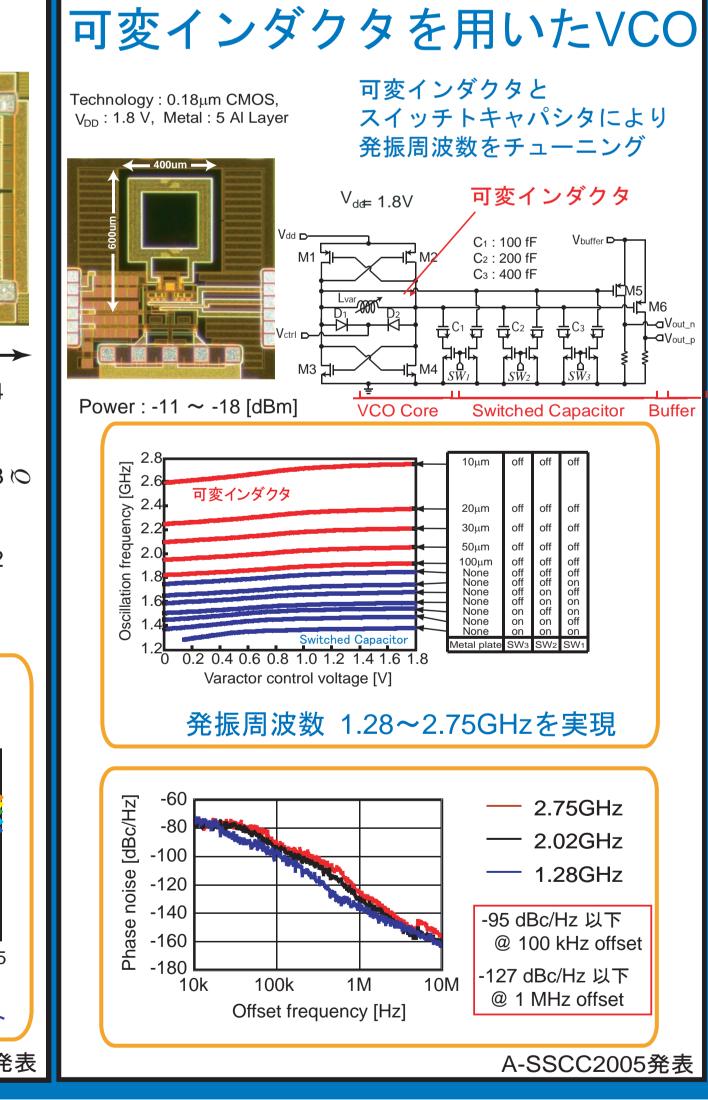
Multi-function



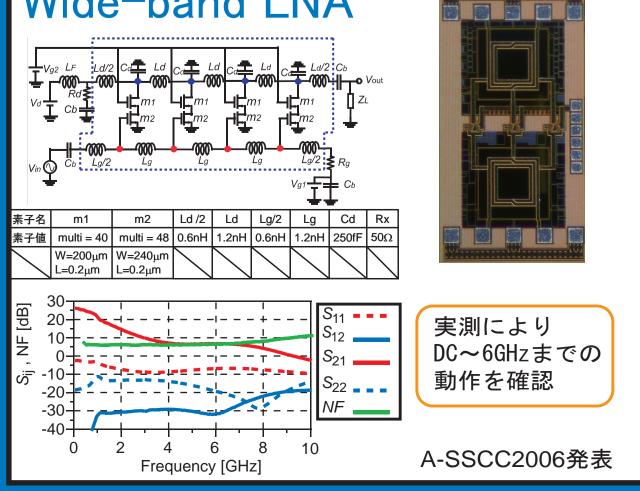
0.98~6.6 GHzの広帯域チューニングを確認。



Vdd=1.8 V 可変インダクタ Pout 50Ω Vdd 6 H<u>J</u>5 3 10 3.5 @1.9 GHz @1.9 GHz $L_{\text{max}}/L_{\text{min}}=1.5$ Lmax/Lmin=2.0 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 Height of plate h [um] Height of plate h [µm] w/o Metal Decrease in Metal Decrease in Metal Plate Height Frequency [GHz] Frequency [GHz] NF: 最小値が高周波側にシフト 利得 > 10dB @ 1.6 - 3.2 GHz EuMC2005発表



Wide-band LNA



可変インダクタ オンチップインダクタと 導体板で構成 MEMSアクチュエータを 線間距離: 1.2um 巻き数: 3μm 用いて導体板を移動 — h=10 μm インダクタの上方に 配置された導体板に よって磁束を遮断 *h*=50 μm stationary electrode 導体板の位置によって -*h*=100 μm インダクタンスが変化 Frequency [GHz] Frequency [GHz] EuMC2004発表

まとめ

再構成可能RF回路技術の提案

DC~6 GHzの範囲で動作を確認

Tunable LNA

1.6~3.2 GHzの範囲でのチューニングを実現

Wide-band LNA

可変インダクタを用いたVCO

発振周波数を1.3~2.8 GHzの範囲でチューニング

広帯域化回路を用いたVCO

発振周波数を0.98~6.6 GHzの範囲でチューニング